

# 半导体产业新闻半月刊（精华版）

2018/0716-2018/0729



# 专题分类



# 并购投资

点评：①紫光集团巨资收购Linxens，以提升全球竞争力。  
②瞄准中国市场，Xilinx收购深鉴科技。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC设计	2018/07/27	紫光集团收购Linxens	<b>战略收购</b> 。这是紫光集团两年内的首笔海外投资。收购Linxens，将进一步拓宽紫光集团的应用边界，提升竞争力。	26亿
电子元器件	2018/07/20	芯智控股拟成立合资公司	<b>市场拓展</b> 。合资公司及其附属公司将主要于东南亚及印度市场提供电子元器件贸易相关的服务，包括但不限于为该集团在这些地区寻找新的客户。	70万
MEMS	2018/07/24	肖特收购Primoceler	<b>战略收购</b> 。通过此次收购，肖特提升了在气密封装领域的长期核心竞争力。	
人工智能	2018/07/18	Xilinx收购深鉴科技	<b>战略收购</b> 。未来，赛灵思将加大对深鉴科技的投入，不断推进从云到端应用领域部署机器学习加速的共同目标。	
人工智能	2018/07/24	旷视科技融资	<b>战略融资</b> 。投资者包含阿里巴巴集团、博裕资本。旷视科技将把这轮融资所得的很大一部分用于支持零售项目，包括将技术应用到无人商店中。	6亿



## 本土产业

点评：①地方产业发展如火如荼，东莞、无锡、南京、昆山、德州等地持续扶持半导体产业。



## 【扬州设立20亿微电子基金】

7月14日，扬州邗江区举行了智能制造、生物健康、微电子三支产业基金集中签约仪式。三支基金的总规模达到37亿元。其中，微电子产业投资基金为20亿元，首期到位5亿元。

## 【南京将出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》】

- ① 南京日报报道，南京市将出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》，明确集成电路产业发展目标。
- ② 到2025年，全市集成电路产业综合销售收入力争达到1500亿元，进入国内第一方阵，在5G通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现全省第一、全国前三、国际知名。
- ③ 支持集成电路产业垂直整合及并购重组，建立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金，加大高端人才引进培育力度等。



## 【《东莞市重点新兴产业发展规划（2018—2025年）》】

**SIIP CHINA**  
SEMI产业创新投资平台

- ① 近日，东莞市发展和改革局正式发布《东莞市重点新兴产业发展规划（2018—2025年）》（以下简称《规划》），东莞未来将发力新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生命科学和生物技术五大重点新兴产业领域。
- ② 《规划》明确提出，到2025年，五大新兴产业领域将带动东莞可持续发展能力显著增强，将东莞建成有全球影响力的先进制造中心和创新型城市。
- ③ 根据《规划》，东莞五大重点新兴产业领域包括新一代信息技术领域、高端装备制造领域、新材料领域、新能源领域、生命科学和生物技术领域等。

## 【京东方精电拟投资车用液晶显示模组项目】

京东方精电发布公告，该公司全资附属公司年加投资有限公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会就车用液晶显示模组及车载智能交互研发平台项目订立了投资框架协议，项目总投资金额为13.57亿元人民币。



## 【中国电科与无锡市将在集成电路等领域展开合作】

近日，中国电科与无锡市签署战略合作协议，双方将围绕集团公司的核心经营领域和无锡市经济社会发展的重点方向，在微电子与集成电路、物联网产业与应用、平台建设、军民融合、设立产业基金等方面开展合作。

## 【无锡滨湖发力集成电路设计】

7月27日，无锡滨湖区举行集成电路设计产业重大项目签约暨2018无锡太湖创“芯”峰会，无锡市与中国信息安全测评中心签订战略合作协议，神威AI、中科芯创芯芯片、深圳天基通讯等15个项目同步签约，涉及芯片设计应用及相关产业，总投资近20亿元。

## 【无锡打造半导体及燃料电池装备生产基地】

7月27日，先导集团总部大楼及半导体和燃料电池装备制造基地在无锡高新区启动建设，项目建成后 will 填补国产装备在这两个领域的空白。项目总投资约50亿元，分两期建设，一期为基于原子层沉积(ALD)技术的半导体装备，新能源汽车氢燃料电池装备的研发及产业化；二期为氢燃料电池汽车配套设施的研发及产业化项目，切入制氢、储氢等细分领域。一期项目达产后，预计可实现年销售收入25亿元、利税总额7亿元。



## 【德州大尺寸硅材料规模化基地项目签约】

7月26日，德州市在济南山东大厦举行集成电路大尺寸硅材料规模化基地项目投资合作签约仪式。项目总投资80亿元，其中一期18亿元，二期62亿元。一期建设目标为新建8英寸硅片生产线，达到年产能180万片8英寸硅片，二期建设目标为年产360万片12英寸硅片。

## 【昆山310亿元半导体产业项目签约】

7月22日，昆山市政府与中科院微电子所及协鑫集团合作建设、投资约310亿元的功率射频半导体产业创新基地项目正式签约，着力将昆山打造成为功率射频半导体产业领域的国际开放创新合作“高峰”、网络强国战略实施“高地”和江苏数字经济产业发展“高原”。

## 【全国首条砷化镓微波芯片产线明年初投产】

北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京市亦庄经济技术开发区建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路（GaAs MMIC）芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。



## 【浙江金华引进 MEMS 芯片项】

7月12日，浙江金华金磐开发区与西安交通大学纳米学院、安徽蓝泽投资有限公司进行光电子与 MEMS 芯片项目签约仪式。签约的这个项目总投资25亿元，还将带动产业链投资25亿元，合计50亿元。

## 【韩国LG化学电池项目落户南京】

- ① 7月17日，总投资20亿美元的LG化学电池项目落户南京滨江。
- ② 该项目计划于今年10月开工建设，2019年10月开始实现量产，2023年实现全面达产。项目达产后，预计年产动力电池32GWh，年产值将达350亿元人民币。

## 【全国首条石英晶体谐振器智能化生产线投产】

近日，位于泸州国家高新区纳溪科技园内的四川明德亨电子科技有限公司的石英晶体谐振器智能化生产线宣布投产，标志着我国压电晶体行业智能化生产线实现零突破，意味着我国将打破日本、韩国等一线厂商在该行业的垄断地位，并具有定价权。

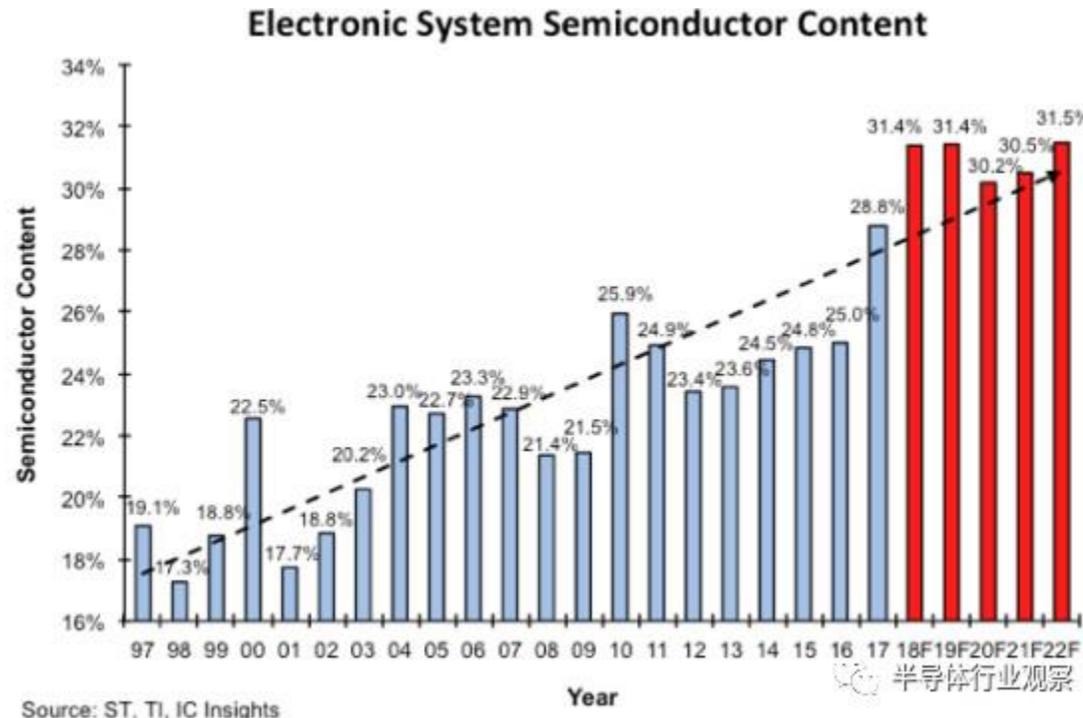


## 市场数据

- 点评：
- ①持续走高，全球半导体产值今年将首度突破5000亿美元。
  - ②未来半导体将持续景气，带动晶圆、存储器高速增长。
  - ③牢牢把持印度市场，Q2小米手机印度出货量再度登顶。



## 【全球半导体产值今年将首度突破5000亿美元】



- ① IC Insights指出，全球半导体产值今年将首度突破5000亿美元大关，预估成长14%至5091亿美元。
- ② 预测全球电子系统将扩增5%至1.6兆美元，若是如此，那么电子系统平均半导体含量将来到31.4%，将打破2017年28.8%的最高纪录。
- ③ IC Insights进一步预测，2020年电子系统的半导体含量将拉回至30.2%，但2022年会再创新高纪录至31.5%。



## 【WSTS: 预估存储全球销售额1567.86亿美元】

WSTS Forecast Summary

Spring 2018	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Americas	88,494	100,853	105,521	35.0	14.0	4.6
Europe	38,311	43,430	45,487	17.1	13.4	4.7
Japan	36,595	39,753	41,440	13.3	8.6	4.2
Asia Pacific	248,821	279,375	291,271	19.4	12.3	4.3
<b>Total World - \$M</b>	<b>412,221</b>	<b>463,412</b>	<b>483,719</b>	<b>21.6</b>	<b>12.4</b>	<b>4.4</b>
Discrete Semiconductors	21,651	23,610	24,659	11.5	9.0	4.4
Optoelectronics	34,813	35,986	38,024	8.8	3.4	5.7
Sensors	12,571	13,306	14,118	16.2	5.9	6.1
Integrated Circuits	343,186	390,509	406,918	24.0	13.8	4.2
Analog	53,070	58,095	61,044	10.9	9.5	5.1
Micro	63,934	66,152	68,582	5.5	3.5	3.7
Logic	102,209	109,476	114,747	11.7	7.1	4.8
Memory	123,974	156,786	162,545	61.5	26.5	3.7
<b>Total Products - \$M</b>	<b>412,221</b>	<b>463,412</b>	<b>483,719</b>	<b>21.6</b>	<b>12.4</b>	<b>4.4</b>

Note: Numbers in the table are rounded to whole millions of dollars, which may cause totals by product group to differ slightly.

半导体行业观察  
Source: WSTS

WSTS预测，存储预估将飙增26.5%至1,567.86亿美元、逻辑电路将年增7.1%至1,094.76亿美元、微电子将年增3.5%至661.52亿美元、逻辑电路将年增9.5%至580.95亿美元。



## 【2018年Q1基带芯片市场份额：三星LSI超过联发科】

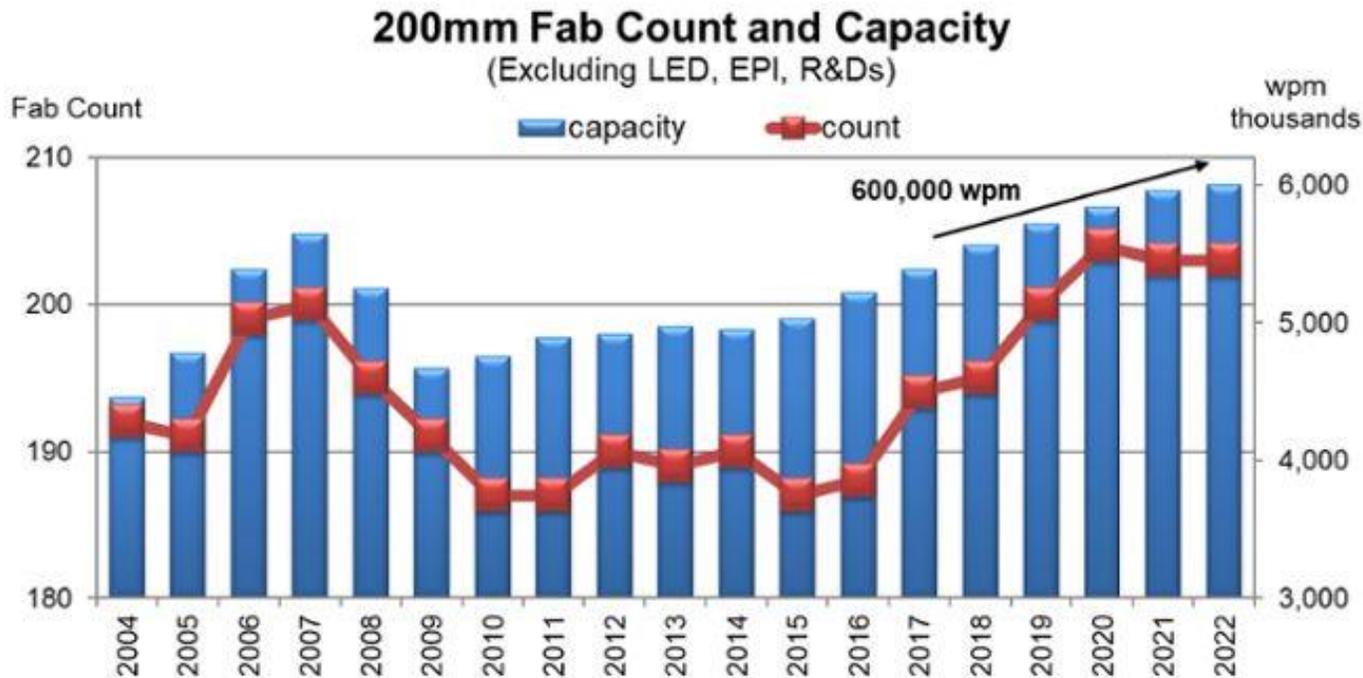
2018年Q1基带芯片市场收益份额：49亿美元



- ① Strategy Analytics指出，2018年Q1全球蜂窝基带处理器市场年同比增长0.3%达到49亿美元。
- ② 高通，三星LSI，联发科，海思和UNISOC（展讯和RDA）在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额囊获前五。高通继续赢取市场份额，以52%的基带收益份额保持第一。其次是三星LSI，占14%，联发科占13%。



【2022年全球200mm晶圆厂月产晶圆将达600万片】



据SEMI预测，全球200mm晶圆厂将在2017~2022年间，实现每月60万片晶圆产能的增加，增长率高达11%，预计到2022年可以实现月产600万片晶圆。



## 【Q2小米手机印度出货量再度登顶】

India smartphone market shares Q2 2018

Rank	Vendor	Q2 2017 share	Q2 2018 share	Growth
#1	 Xiaomi	18%	30%	106%
#2	SAMSUNG	25%	30%	47%
#3	VIVO	13%	11%	32%
#4	OPPO	9%	10%	5%
Others		35%	19%	-35%
Total smartphones		26.8 million	32.6 million	22%

Source: CanaIys estimates, Smartphone Analysis, July 2018

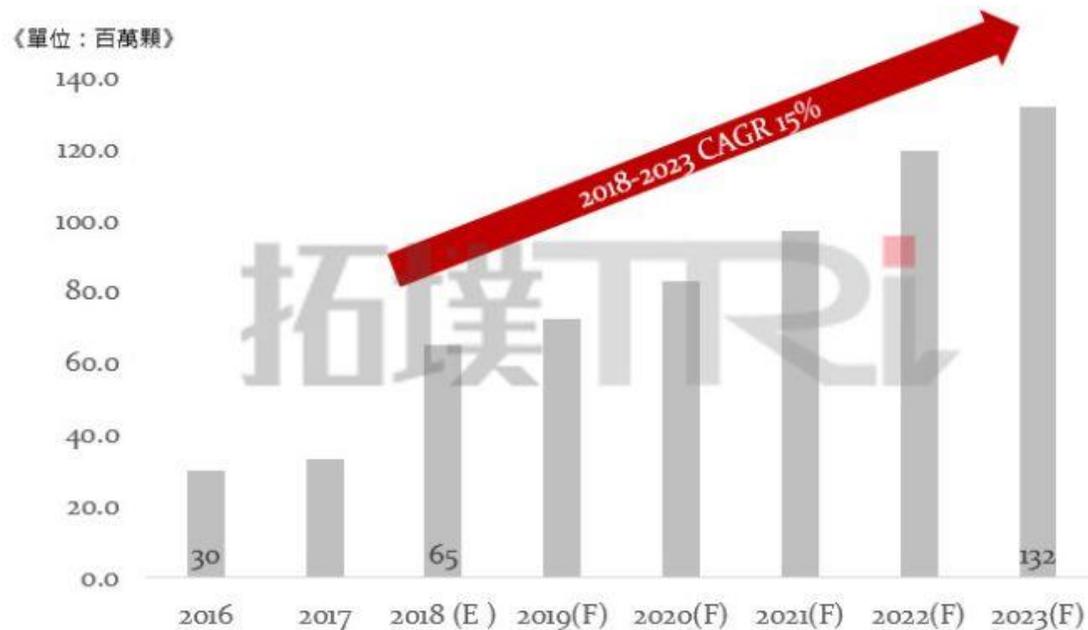


- ① CanaIys统计，在刚过的第二季度，小米和三星在印度智能机市场的合并份额从去年的43%提升到创纪录的60%。
- ② 其中小米出货超990万台，占比30.4%，同比增长106%；三星出货990万台，占比30.2%。同比增长47%。



# 【车载毫米波雷达进入高速成长阶段，至2023年CAGR 15%】

圖、前裝車載毫米波雷達市場規模



資料來源：拓璞產業研究院，2018/07

資料來源：TrendForce集邦科技

TrendForce旗下拓璞产业研究院最新报告指出，车载毫米波雷达受到中国大陆新版新车评价指标(C-NCAP)实行，与美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的驱动下，将进入高速成长阶段，预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6,500万颗，2018-2023年年复合成长率(CAGR)达15%。



## 【中国乘用车头灯用LED产值2022年有望达80.84亿】

集邦咨询LED研究中心最新《2018中国车用照明市场报告》显示，中国乘用车的头灯用LED产值在2022年预估将达到12.1亿美金，为各项车用应用中最高。



## 财报信息

点评：①受惠于全球半导体产业繁荣，英特尔、高通、SK海力士、日月光等Q2营收大增。  
②受美国制裁影响，中兴Q1巨亏。



领域	公司	年份	营收 (美元)	净利润 (美元)	同比/环比	原因说明
IC、IT	IBM	Q2	200亿	24亿	营收同比增4%；净利润同比增3%。	来自于持续运营业务的运营的贡献较多。
IC设计	高通	Q3	56亿	12.2亿	营收同比增4%；净利润同比增41%。	
IC制造	英特尔	Q2	170亿	50亿	营收同比增15%；净利同比增78%	
IC制造	AMD	Q2	17.6亿		营收同比增53%。	计算与图形事业部和嵌入式和半定制事业部等的增长。
IC制造	台积电	Q2		76.1亿	净利润同比增9.1%；环比降6%。	主要是移动业务季节性收入减少造成的。
IC制造	南亚科	Q2	8亿		净利润环比增30.8%。	DRAM市场仍供不应求，带动存储器产品的行情上涨。
IC制造	联电	Q2	12.7亿	1.2亿	营收同比增3.6%。	主要来自电脑周边与通讯应用。
IC制造	SK海力士	Q2		38.4亿	净利润同比增75.4%。	归因于DRAM和NAND闪存产品的出货量急剧上升。
IC装备	ASML	Q2	31.9亿	6.8亿	营收同比增30.4%；净利润同比增25.3%。	EUV贡献营收。
IC装备	北方华创	上半年	2亿	0.17亿	营收同比增33.4%；净利润同比增125%。	增长主要系电子工艺装备销售收入较去年同期有所增加。
IC封测	日月光	Q2	27.7亿	3.8亿	营收同比增28%；净利润环比增447%。	
传感器	Ams	Q2	2.5亿	亏0.48亿	营收同比增18%。	亏损因为第二季度的消费业务中订单量显著降低造成的。
通信	中兴	Q1	4亿	亏7.9亿	营收同比增6.9%。	亏损主要是由于公司计提10亿美元罚款等。
显示照明	LG显示	Q2	49.7亿	亏2亿	营收同比降15%。	亏损是因为全球面板行业面临不确定性。

## 产业合作

点评：①为进军智能及传感领域，美的集团与霍尼韦尔展开战略合作。  
②为突破工业自动化方面的障碍，微软、通用电气强强联手。



领域	合作公司/单位	目的
存储器	Intel、美光	双方将携手开发第二代3D Xpoint闪存芯片。
MEMS	英特尔、SiTime	双方将携手开发应用于英特尔5G调制解调器平台的微型低功耗MEMS时钟解决方案。
智能、传感	美的集团、霍尼韦尔	美的集团与霍尼韦尔将首先在智能及传感、材料等领域进行深度创新战略合作。霍尼韦尔科技事业部（中国）将为美的集团提供定制化业务，针对相关领域的前瞻性研究提供支持。美的集团将促进霍尼韦尔对市场需求的洞察力提升。
工业自动化	微软、通用电气	将运营技术和信息技术结合起来，以消除工业企业在推进数字化转型项目方面所面临的障碍。
自动驾驶	Renovo、NIRA Dynamics	移动出行软件初创企业Renovo与瑞典公司NIRA Dynamics合作，为自动驾驶车队提供路面监测。



## 设计制造

- 点评：
- ①合肥长鑫正式投片，国产DRAM开启新篇章。
  - ②新昇快速提升大硅片产能，计划年底月产能10万片。
  - ③存储器市场持续获利，三星、东芝加大投资力度。



## 【合肥长鑫DRAM正式投片】

7月16日，国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储，国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破，为推动存储国产化掀开了重要一页。

## 【三星150亿美元扩大NAND产能】

韩媒报道，三星已经上调了今明两年在NAND生产上的投资，总计高达150亿美元，这主要用于扩大韩国平泽工厂以及中国西安工厂的3D NAND产能。报道中提到，三星如此投资，只是为了提高NAND产量，所以未来SSD的继续降价是基本没悬念的事。

## 【上海新昇计划2018年底月产能达10万片】

7月23日，上海新阳在互动平台上表示，该公司参股的上海新昇的最新建设计划为至2018年底达到月产能10万片。上海新昇正片目前通过了上海华力微电子的验证，尚未通过台积电的验证。



## 【东芝最大的3D闪存工厂开建】

近日，东芝存储器在日本东北部地区岩手县北上市举行了首个半导体晶圆制造厂K1的奠基仪式。该工厂计划于2019年秋季竣工，专门从事3D闪存的生产。

## 【长江存储将首次公布新型3D NAND架构】

近日长江存储官方透露，将于8月份在美国首次公布新型3D NAND架构Xtacking，据称该技术可将NAND传输速率提升至DRAM DDR4相当的水准，同时使存储密度达到行业领先水平，实现闪存行业的划时代跃进。

## 【华为Kirin 980参数曝光，或带自研GPU】

DIGITIMES日前曝光了华为新一代旗舰麒麟980处理器的规格，包括采用7nm制程工艺，同时CPU的主频可以达到2.8GHz。DIGITIMES表示，麒麟980处理器将会搭载4个A77+4个A55，GPU方面麒麟980或将搭载华为自主研发的图形处理器，性能大约是高通骁龙845所搭载的Adreno 630的1.5倍左右。如果爆料属实，华为Kirin 980的亮相，将给国内的芯片设计产业带来重大的鼓舞。



## 产品应用

点评：①存储器领域火爆，各厂商纷纷推出新产品。  
②助力5G规模商用，高通推出全集成5G新空口（5G NR）毫米波及6GHz以下射频模组。



领域	公司/单位	产品及特性
IC设计	ADI	宣布推出一款SiGe宽带合成器，集成了压控振荡器（VCO），据称可在单芯片上提供业界最低的相位噪声性能。
IC设计	美国VPT公司	推出SVPL系列宇航级至负载点（POL）DC-DC转换器。
存储器	西数、东芝	成功开发采用96层BiCS4架构的第二代3D QLC NAND，预计将在2018年下半年量产。
传感器	Emcore	展出新的小型军用光纤陀螺仪，是目前同一性能水平上尺寸最小、性价比最高的FOG惯性测量装置（IMU）。
传感器	Teledyne e2v公司	宣布正在开发小型卫星用新型CMOS图像传感器。
传感器	索尼	发布了全新的摄像头传感器IMX 586，新传感器拥有4800万有效像素，并支持全像素30fps输出。
5G	高通	推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口（5G NR）毫米波及6GHz以下射频模组，包括QTM052毫米波天线模组系列和QPM56xx 6GHz以下射频模组系列，均可与骁龙 X50 5G调制解调器配合，提供从调制解调器到天线且跨频段的多项功能，并支持紧凑封装尺寸以适合于移动终端集成。
显示照明	三星	宣布了一款不易损伤的智能机OLED面板，其还通过了UL军规认证。这意味着它已准备好向实际设备中的消费者发货。
玻璃基板	康宁	发布第六代大猩猩玻璃，相比第五代产品，它在这一代重点加强了连续跌落的抗摔能力，经受15次从1米的高度到粗糙表面的跌落，比第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。



# 大国重器

点评：①ARPA启动新项目“小虾”，旨在研究微米尺寸致动器的材料和高能效功率系统。  
②重视未来军事，德国想在一年内成立自己的DARPA。



## 【DARPA启动新项目“小虾”】

“小虾”（SHRIMP）项目寻求推进多功能毫米到厘米尺寸机器人平台的发展。该项工作的核心是研究微米尺寸致动器的材料和高能效功率系统，满足“尺寸-重量-功率”（SWaP）极端有限的微机器人系统的使用。研究成果将支持包括搜索与营救、灾后复原、恶劣环境勘测、航空动力平台飞行控制、可控光学、外科修复等领域在内的应用。项目计划投入3200万美元，时长3年。

## 【德国想在一年内成立自己的DARPA】

- ① 德国国防部和内政部官员正推动成立一个新机构。该机构将研究德国国防与安全相关的颠覆性技术。
- ② 该机构全名为“赛博安全和关键技术颠覆性创新机构”（Agentur für Disruptive Innovationen in der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien, ADIC）。
- ③ 德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩在今年5月的一次讲话中提到该新机构，将其作用等同于美国国防高级研究计划局（DARPA）。在德国军方开始重视赛博领域的背景下，这个新机构是基于对未来赛博安全问题深入思考的更大计划的一部分，另外还包括在慕尼黑联邦国防军大学设立的一个研究项目，以及去年国防部成立的赛博创新中心。该中心计划调研德国国内科技创业公司现状，以获得有潜力的军事应用想法。

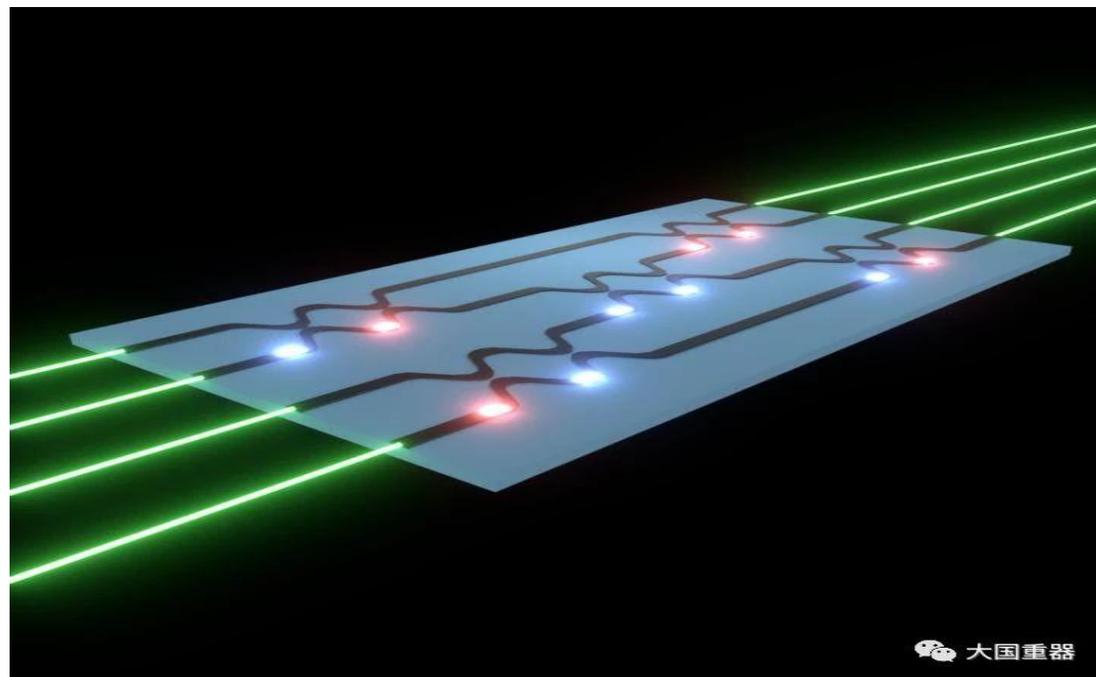


## 科技前沿

点评：①基于光模拟“反向传播”算法，斯坦福大学证实可在一个光芯片上训练人工神经网络。  
②IBM展示神经形态数字突触超级计算机，兼具高性能和低功耗。



## 【斯坦福大学证实可直接在一个光芯片上训练人工神经网络】



大国重器

- ① 美国斯坦福大学的研究人员展示了直接在光芯片上使用光模拟“反向传播”算法的方式可训练人工神经网络，证实直接在一个光芯片上训练人工神经网络的可能性。
- ② 该重大突破性进展展示了光电路能够实现基于电子的人工神经网络的重要功能，并能够以更廉价、更快和更高能效的方式来执行类似语音或图像识别等复杂任务。“反向传播”算法是训练传统神经网络的标准方式。



## 【IBM展示神经形态数字突触超级计算机】

- ① IBM和美国空军研究实验室（AFRL）官员在AFRL的信息局先进计算应用实验室中展示全球最大神经形态数字突出超级计算机。
- ② 根据AFRL的文件，该超级计算机名为“Blue Raven”，其端到端的IBM“真北”生态系统目标是提供6400万神经元和160亿个突触的等效处理能力，而功耗仅有40瓦，相当于一个家用灯泡。



# 人事变迁

- 点评：
- ①因工作需要，紫光国微董事长李明辞职。
  - ②朱一明接任合肥长鑫CEO，标志长鑫迈入新阶段。
  - ③小米上市后首次高管调整，颜克胜升任集团副总裁。



## 【紫光国微董事长李明因工作需要辞职】

紫光国芯微电子股份有限公司发布公告称，董事会于2018年7月18日收到董事长李明的书面辞职报告。根据紫光集团的统一安排，因另有工作需要，李明辞去紫光国微第六届董事会董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。李明辞去上述职务后，不在紫光国微担任任何职务。

## 【朱一明接任合肥长鑫CEO】

7月16日，兆易创新原董事长朱一明，宣布辞去兆易创新CEO，由王宁国手上正式接任合肥长鑫存储及睿力CEO。

## 【中国联通宣布李国华调任公司总经理】

- ① 7月19日，中国联合网络通信集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。
- ② 会上，受中组部领导委托，中组部有关干部局主要负责同志宣布了中央关于中国联通总经理调整的决定：李国华同志任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国邮政集团公司总经理、党组书记职务。



## 【颜克胜升任小米集团副总裁】

- ① 近日，小米集团董事长雷军发布内部信宣布最新的人事任命，这也是上市后首次调整高管团队。
- ② 最新任命原手机部副总裁颜克胜为集团副总裁，兼任集团质量委员会主席，直接向雷军汇报；同时任命张健担任集团质量办主任，向颜克胜汇报。任命即日生效。

## 【百度IDL杰出科学家徐伟宣布离职，将入职地平线】

百度深度学习实验室（IDL）杰出科学家徐伟宣布离职百度，其还称将加入地平线机器人（Horizon Robotics）并担任通用AI首席科学家（Chief Scientist of General AI）。



## 焦点关注

点评：①未得到中国商务部的批准，高通收购NXP以失败告终。



## 【高通放弃收购NXP】

- ① 7月26日，经过了一年多时间的审核，高通收购恩智浦的交易最终没能等来中国监管机构的一纸批文。
- ② 这意味着这起历经21个月，金额高达440亿美元，半导体行业迄今最大规模的并购案以失败告终。高通方面宣布了这一结果。
- ③ 业界猜想，这可能与最近的中美贸易战及中兴事件相关。
- ④ 但在商务部例行发布会上，商务部发言人高峰被问及相关问题时，表示这是一个反垄断问题，与中美贸易摩擦无关。



## 专利要闻

点评：①智能手机竞争激励，龙头企业竞相申请新专利。  
②全球区块链专利超5000件，中国占一半。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	弹性基板将使iPhone配上柔性屏。
新专利	苹果	用MacBook和iPad给iPhone无线充电。
新专利	苹果	这种专利会根据乘客的反应改变其驾驶方式，并使用监测传感器分析车辆的使用者以确定合适的驾驶风格，从而降低乘客产生恐慌的可能性。
新专利	三星	配备柔性屏幕以方便自拍。
新专利	微软	微软Surface双屏本，用于改善触屏打字体验。
纠纷	Fractus、OPPO	西班牙公司Fractus针对OPPO提起诉讼，指控其侵犯天线技术专利。
纠纷	Groupon、IBM	美法院裁定Groupon专利侵权 赔偿IBM 8300万美元。
纠纷	Nitride	日本知名UV LED厂商Nitride对两美企提起专利诉讼。
纠纷	高通	高通再遭欧盟反垄断调查，最多可能被罚23亿美元。
数据	中国	全球区块链专利申请超5000件，中国占一半。



# SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



## 联系我们

SEMI中国 Lily Feng  
Tel: +86-21-60278500  
E-MAIL: lifeng@semi.org  
<http://www.semi.org.cn/siip>

**订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取**  
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)  
SEMI中国 Lily Feng  
E-MAIL: lifeng@semi.org

